

**에이직랜드, 대만 이지스테크놀로지와 글로벌 AI 서버 칩 공동 개발 협력**

- ▶ 첨단 IO 칩렛 솔루션 개발로 고성능 데이터센터 시장 공략할 것
- ▶ 글로벌 파트너사들과 협력 통한 글로벌 시장 입지 강화

[2024-11-06] 에이직랜드가 대만 이지스테크놀로지와 손잡고 고성능 데이터센터 시장을 공략한다.

**ASIC(주문형반도체) 디자인솔루션 대표기업 에이직랜드(445090, 대표이사 이종민)가 차세대 AI 및 고성능 컴퓨팅 반도체 솔루션 기업 이지스테크놀로지(Egis Technology Inc., 이하 이지스)와 AI HPI(High-Performance Computing) 서버칩 공동 개발 협력을 위한 전략적 파트너십 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.**



사진설명: 에이직랜드 대만 법인에서 이지스그룹과 에이직랜드가 글로벌 AI 서버 칩 공동 개발 협력을 위한 MOU를 체결하고 있다. (왼쪽 Steve Ro. Egis 그룹 회장, 오른쪽 이종민 에이직랜드 대표이사)

이번 계약의 목표는 고성능 데이터센터 시장 공략을 목표로 고도화된 IO(Input/Output) 칩렛(Chiplet) 솔루션을 제공하는 것이다. 구체적으로 'CPU 칩', 'AI 칩', 'IO 칩', 'IP 라이선스(UCIe, LPDDR5, PCIE5/6)', 첨단 CoWoS 패키징 개발 등 여러 핵심 기술들에 대한 협력을 진행할 예정이다.

먼저, 에이직랜드의 ASIC 칩 설계 전문성 및 TSMC의 첨단 공정 기술과 이지스의 'UCIe' 및 'LPDDR5



IP' 기술을 결합한 IO 칩 개발에 초점을 맞춘 계획이다. 이는 한국을 시작으로 향후 글로벌 시장으로 확장해 양사의 글로벌 경쟁력을 높이고자 한다.

이지스는 차세대 AI 및 고성능 컴퓨팅 기술에 적합한 반도체 솔루션을 제공하며, 칩렛 아키텍처와 같은 혁신적인 기술을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여가고 있는 회사다. 특히, Arm과의 협력, AI 서버 솔루션 및 자체 보유 중인 UCle를 비롯한 고속 인터페이스 IP 기술을 통해 지속적으로 기술력을 강화하고 있다.

에이직랜드 이종민 대표이사는 "이지스와의 파트너십을 통해 고성능 데이터센터 시장에서 필요한 핵심 기술을 강화하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높일 예정"이라며, "앞으로도 글로벌 파트너사들과 협력을 강화하며, 반도체 첨단공정에 대응할 수 있는 독보적인 기술력을 선보일 것"이라고 전했다.